

2007年4月23日

エルピーダメモリ株式会社
秋田エルピーダメモリ株式会社

秋田エルピーダメモリ 世界最薄 1.4mm、20 段チップ積層パッケージ開発に成功



秋田エルピーダメモリ株式会社（秋田県秋田市、代表取締役社長 渡辺敬行 以下、秋田エルピーダ）は、このたび、世界最薄 1.4mm 厚で 20 枚のチップを積層したパッケージ開発に成功しました。

秋田エルピーダは、最先端 DRAM のリーディングサプライヤーであるエルピーダメモリ株式会社（東京都中央区、代表取締役社長兼 CEO 坂本幸雄 以下、エルピーダ）が昨年 7 月に設立し、同年 10 月に操業を開始した半導体後工程を担う新会社です。株式会社日立製作所のグループ会社として培ってきた高い技術力と製造ノウハウをベースとして、現在、2 段および 3 段のチップ積層品を中心にして MCP (Multi Chip Package) や PoP (Package on Package) といった先端・高付加価値パッケージの開発、生産に注力しています。

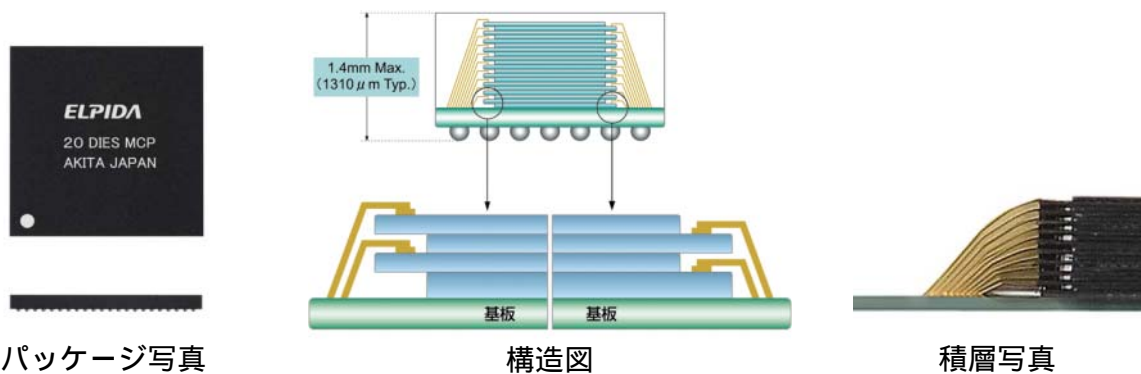
昨今の携帯電話やデジタルスチルカメラなどのポータブル機器のさらなる小型・薄型化と高機能化に伴い、それらを実現するロジックや DRAM、フラッシュメモリなどの半導体製品への要求も高度化しており、半導体チップを 5 段、7 段と積層し、かつ小型・薄型を実現したパッケージの需要が高まりつつあります。

そのような市場のニーズに応えるべく、秋田エルピーダの開発グループにおいて、多積層でかつ薄型のパッケージ開発に取り組み、今回の世界最薄 1.4mm 厚・チップ 20 枚の積層パッケージの成功に至りました。

今回、この世界最薄のパッケージ開発を成功に導いた、秋田エルピーダの持つ高い技術力を工程順に紹介します。

1. チップ厚 30 μm を実現するウェハ研削技術
2. 30 μm 厚ウェハのハンドリング技術
3. 30 μm 厚薄チップのピックアップ、ダイアタッチ技術
4. 40 μm の低ループワイヤボンディング技術
5. オーバーハングワイヤボンディング技術
6. 狭間隙への樹脂充填技術

秋田エルピーダでは、今後、本パッケージ技術を生かし、すでに存在する 5 段、7 段などの多チップ積層パッケージの高歩留りで低コストの生産技術を確立し、ビジネスの拡大を図る所存です。さらには、今後も、装置メーカおよび材料メーカ各社の協力を得て、顧客や市場のニーズに応える先端・高付加価値パッケージ開発やその生産技術の開発に積極的に取り組んでまいります。



以上

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

●報道関係からのお問い合わせ先
エルピーダメモリ株式会社
広報グループ
電話：03-3281-1648
E-mail：press@elpida.com